

# 大型高温真空加熱装置 - 1000℃ -

## ■ 用途

真空排気、最高 1000℃の加熱処理を自動運転で行えます。

処理雰囲気は、高真空、アルゴン・水素などの不活性・還元性雰囲気の選択が可能です。

半導体装置用真空機器、加速器用真空機器、医療用部品などの高温熱処理に活躍しています。

高融点金属・セラミックス等の改質、アニール、エージングなど各種ご要望に応じたカスタマイズをご提案いたします。

【導入分野】 量産向け生産、研究開発、試作品開発



## ■ 特徴

排気、熱処理プロセスを自動で行うことができる横型真空熱処理装置です。

試料は付属の専用台車上ステージに設置し、真空槽内に挿入します。

ヒーターエレメントはモリブデンを標準とし、雰囲気に応じて提案します。

ドライな排気系で構成され、清浄な雰囲気で処理が行うことができ、またプロセスに応じた各種ガスを導入することが可能です。

ドライ真空ポンプを補助排気系に備え、ターボ分子ポンプおよびクライオポンプによる主排気によって  $10^{-6}$  Pa 台の到達真空圧力を標準仕様とします。クリーンな雰囲気が要求される処理に対応します。

お客様の御要望に沿って、雰囲気、ワークステージ、昇温条件にお応えしています。

## ■ 仕様

### 大型高温真空加熱装置－1000℃－

排気性能	到達圧力	$\leq 5.0 \times 10^{-6}$ Pa	制御系	主操作	制御盤 PLC 操作
	排気時間	$\leq 1.0 \times 10^{-2}$ Pa (DRP+TMP) 60 min 以内		自動動作機能	排気系動作 プロセス運転
真空槽	真空槽	SUS チャンバ (水冷ジャケット式)	オプション	ベントガス (増設、変更)	Ar 他
排気系	主排気ポンプ	クライオポンプ ターボ分子ポンプ (水冷)	ユーティリティ	プロセスガス	O <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> 他
	補助ポンプ	ドライ真空ポンプ or 油回転ポンプ		電力・接地	主電源系 3φ AC210V 730A 50/60 Hz
	各種バルブ	PLC 操作(自動および手動)		冷却水	供給圧：0.2 ~ 0.3 MPa 水温：20 ~ 35 °C 水量：≥ 200 L/min
真空計	低真空	ピラニ真空計		ベントガス	窒素ガス 0.1 ~ 0.15 MPa
	高真空	電離真空計		圧縮空気	0.5 ~ 0.8 MPa
槽内アクセス	アクセスポート (正面扉)	O リングシール		設置面積	(W×D×H) =10150mm×4000mm×2500mm
機能	加熱温度	常用 750 °C MAX 1000 °C			
	有効加熱範囲	(W×H×L) =1000mm×1000mm×2000mm			
	昇温速度	750 °C / 150 分 (無負荷)			

弊社工場に真空加熱炉を備えています。

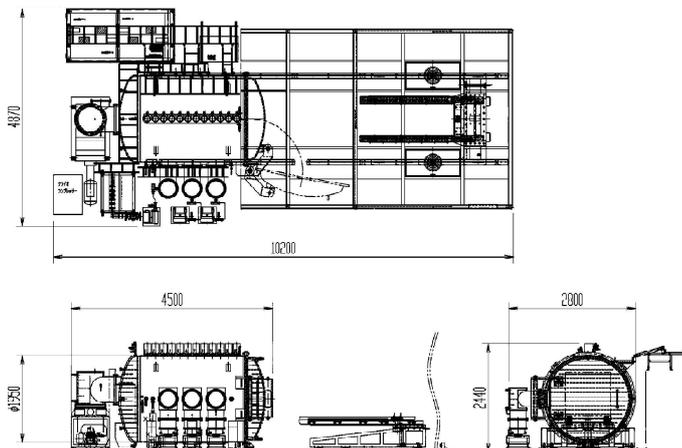
到達圧力  $3.0 \times 10^{-6}$  Pa

有効加熱範囲 (W×H×L) = 800mm×800mm×1800mm

加熱制御温度 300~750°C

装置導入をご検討の方の見学、真空加熱処理の製品試験をされたい方の御要望をお受けしております。

詳細は弊社までお問い合わせください。



## ■ 株式会社 日本シード研究所

本社・工場： 〒252-1125  
神奈川県綾瀬市吉岡東 2-3-27

電話： 0467-77-4351

FAX： 0467-77-9858

URL： <https://www.seed-lab.com>

※外観・仕様については改善のため予告なく変更することがあります。  
2024.11